

简介

TACFlux®10-ULR是一款无卤、免洗的倒装芯片浸蘸型助焊剂，其残留物良性、透明。残留物的减少可帮助优化底部填充胶，并减少底部填充胶固化时可能产生的排气现象。

特点

- 专门为倒装芯片浸蘸型应用设计
- 粘性能在封装过程中粘住大芯片
- 无气泡真空包装
- 醒目的红色有助于检测

属性

属性	数值	测试方法
助焊剂类型	RELO	J-STD-004 (IPC-TM-650: 2.3.32 & 2.3.33)
颜色	淡黄色	肉眼观察
典型黏度	1475cps	Brookfield DV-I. 40CPE Spindle @10rpm (3分钟后)
典型酸值	39mg KOH/g	滴定法
表面绝缘电阻 SIR (ohms)	合格	J-STD-004 (IPC-TM-650: 2.6.3.3 IPC-B-24)
回流后残留物比重 (典型值)	<5%	TGA数据
使用寿命	≥ 8 小时	客户反馈 (浸蘸)
保质期	1年 (0-30°C)	黏度变化/显微镜检查

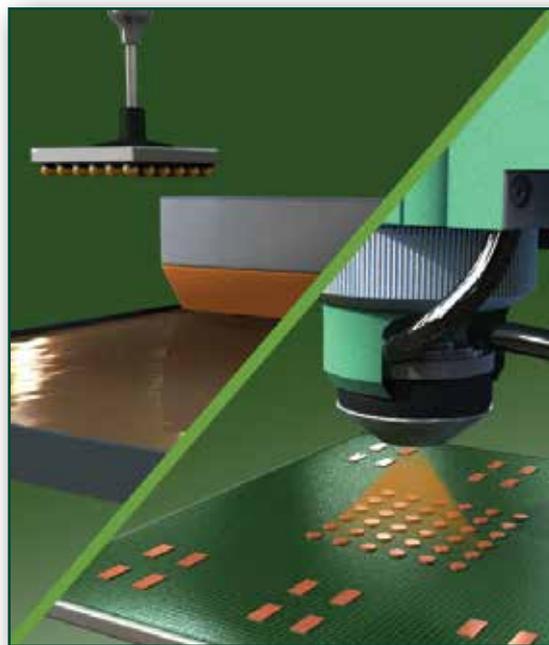
所有信息仅供参考，不作为订购产品的规格说明。

应用

TACFlux®10-ULR在环氧树脂型底部填充胶（尤其是环氧胺和环氧酸等材料）上的粘性很强。TACFlux®10-ULR也适用于很多环氧酞型的材料。

清洁

TACFlux®10-ULR专门为免洗应用设计。如果需要，助焊剂可以用市售助焊剂清洗剂去除。适配清洗剂的选择请咨询钢泰公司的工程师。



技术服务

钢泰公司拥有经验丰富的国际工程师可为我们的客户提供深度技术协助。技术支持工程师深谙电子和半导体封装领域中材料科学应用的各个方面，其快速应答和随时提供现场技术支持的高品质服务设立了行业标杆。钢泰公司的技术支持工程师竭诚为您服务，将第一时间回应所有技术咨询。

安全说明书

如欲获取本产品的安全说明书，敬请访问：
<http://www.indium.com/sds>。

翻页 →

TACFlux®10-ULR

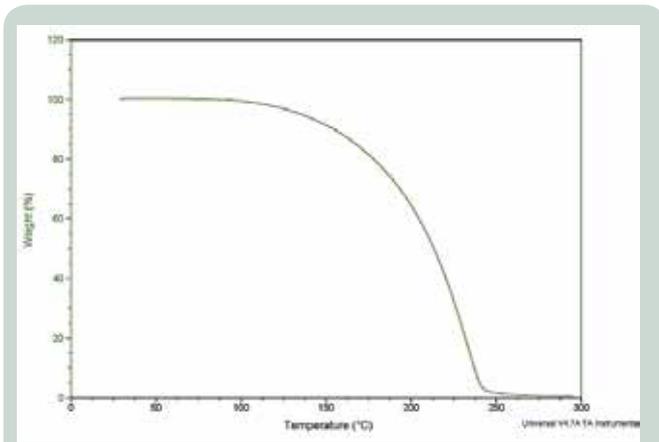
包装

TACFlux®10-ULR的包装规格通常为100克到3.2千克（1加仑）。其它特殊包装可应求提供。

储存

为了保证最长的保质期，TACFlux®10-ULR应尖头朝下储存（0-30℃）。TACFlux®10-ULR应在使用前升温到工作环境温度。

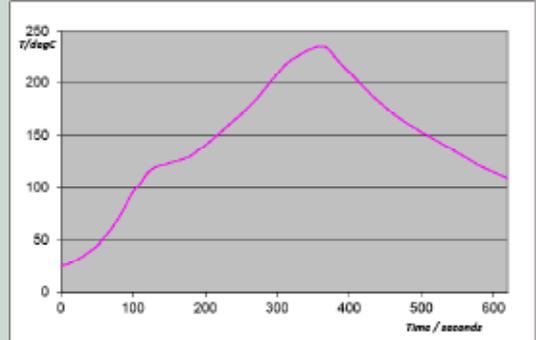
热重分析（TGA）



热重分析（TGA）采取的升温速度为10°C/分钟。

回流

推荐的温度曲线



TACFlux®10-ULR应使用氧气含量低于100ppm的氮气气氛进行回流。尽管取得最佳结果仍需惰性气氛，某些应用可采用空气。TACFlux®10-ULR可在多种表面上使用，包括浸银、铜和AuNi。这些表面可用无铅合金进行焊接，然而当温度超过240°C以后需要使用氮气气氛回流。

本产品说明书仅供参考，并不对所描述的性能做任何担保。具体质保信息请参见产品合同、发票或者发货单里的文字说明。除特别说明，钢泰公司的产品和解决方案均市场有售。

立即联络: china@indium.com

更多详情: www.indium.com

中国 +86 (0) 512 628 34900 • 亚洲 +65 6268 8678 • 欧洲 +44 (0) 1908 580400 • 美国 +1 315 853 4900



©2017 Indium Corporation